

回路開発から組み立てまで 合言葉は「TOTAL BEST」



株式会社村上電子工学

**難易度の高いプリント基板を
社内で一貫製作**

設計から出荷まで38にもおよぶ工程が要求されるのが、プリント基板製作という事業だ。電気にかかわるもののほぼすべてに内蔵されているといつても過言ではない。それらの用途はゲーム機、各種制御装置、パチンコ台等。特殊技術や専用機器を必要とする難易度の高いプリント基板の製造を、村上電子工学では自社で一手に行っている。

「社内で一貫製作することで、効率がアップします。納期も短縮できますし、品質管理も徹底できます。顧客の要求を満たし、信用に応えるためには、自社での製造が必要だと感じました」と、村上孝治社長は語る。



小回りの良さを活かし、試作品からロットまで、幅広い注文に対応できるのも特長。プリント基板に関わる回路開発、実装、組み立てまで、「TOTAL BEST」を合言葉に、何でもできる応用力を高めてきた。

「長い付き合い合いの企業が多く、20年以上取引を続けているところもあります。ものづくりには義理人情も大切。期待を裏切らないことを心がけています」。

約束は必ず守り、困った時には助け合う。「浪花節経営」が息づいている。「スマートさはないけれど、人情味はあります」との声も、社内から聞こえてきた。

積層プレスで高多層化に対応

近年、特に集積回路の高密度化・高速化に伴い、プリント基板も高密度、高多層化の傾向にある。同社では高多層板に対応するため3台の積層プレスを用意。またCAD・CAMを利用し、ネットリストの入力から回路レイアウト配線チェックまでを行ったり、クリーンルーム内で自動レーザープロッターを使い、高精度なパターンに対応できるフィルムも製作している。

品質管理も万全だ。不良品を減らすことを重要な目標に掲げる同社。各工程で月1回のミーティングを持ち、不良の発生原因を突き止め、改善している。

「不良品をいかに出さないかを考え、ヒューマンエラーを発生させないオペレーションを考えています。設備投資も

積極的に行い、少しずつ成果が上がっています。原料高騰が続いています

が、不良品を減らすことで、原料の値上げ分を吸収することにも成功しました」と村上社長は話す。

今のうちに基板の多層化を開発し、ゆくゆくは22〜40層ぐらいの基板まで製作できるように、技術のレベルアップを図りたいという。

「新たな技術への挑戦も始まっていますが、品質体制の強化も付加価値アップにつながります。品質、納期、コスト。三位一体で顧客満足度の高い製品を作っていきたいと思っています」。

主な事業内容

片面・両面・多層プリント基板（4層から12層）の設計から製造販売、多層基板（12層以上）、その他基板（ビルドアップ、IVHなど）の設計から販売等



村上孝治さん
代表取締役

Company Profile

株式会社村上電子工学

住所 〒547-0002
大阪府大阪市平野区加美東2-4-20
設立 昭和44年4月
資本金 2,000万円
従業員 90名（平成21年1月現在）
TEL 06-6793-5546
FAX 06-6793-3756

大阪
16

<http://www.murakami-elec.co.jp/>